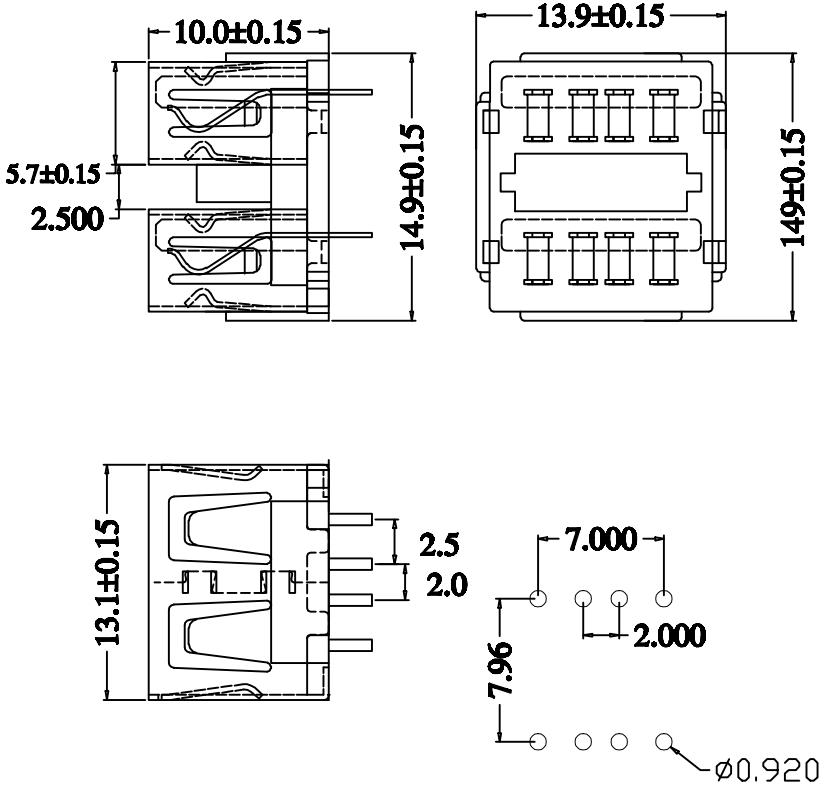
由 Autodesk 教育版产品制作

Mapx	Modification	Date	Draw	Approve
1				



NOTES:
1. MATERIAL SPECIFCATION
1) INSULATION MATERIAL THERMOPLASTIC.
2) SHELL:COPPER ALLOY/SPCC, T:0.30mm
PLATING: NICKEL
3) TERMINAL:COPPER ALLOY, T:0.25mm
PLATING: GOLD/TIN PLATED.
2. ELECTRICAL CHARACTERISTIC:
1) INSULATION RESISTANCE:1000MΩ MIN.
2) CONTACT RESISTANCE:30mΩ MAX.
3) WITHSTANDING VOLTAGE:500V AC.
3. MECHANICAL CHARACTERISTICS:
1) INSERTION FORCE:3.57Kgf MAX.
2) EXTRACTION FORCE:1.02Kgf MIN.

ORDERING INFORMATION

A 02-D X X X X 0 X-1063

- 包装方式区分码: 1:格子盒
- 胶芯颜色区分码: 0:白色
- 胶芯材质区分码: 1:PBT 2:LCP
- 端子电镀区分码: 1:G/F 1U" 引脚光铜
- 外壳电镀区分码: 1:NI≥60μ" 2:NI≥80μ" 3:NI≥100μ" 4:NI≥150μ"
- 外壳材质区分码: 1:Copper Alloy 2:SPCC
- D:DIP
- USB 2.0 F
- A TYPE

成品图 MANUFACTURE DWG / 公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE												
Shenzhen City Xiangyunfeiwu Technology Co., Ltd.												
.X±0.15	X.±5'	? ? DATE	DATE	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING	DRAWIN	图号 DWG NO.	DWGNO.			
.XX±0.05	.X±2'	? ? CHECXED	CHECXED	比例 SCALE	1 : 1	设计 DESIGN	DESIGN	品名 NAME	10.0A母外壳			
.XXX±0.02	.XX±1'	? ? APPROVE	APPROVE	角法 VIEW				版本 VER	VER	页数 SHEET	PG1	

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作